

# 2023-2029年中国IC载板（封装基板）行业市场供需态势及发展前景研判报告

报告大纲

## 一、报告简介

智研咨询发布的《2023-2029年中国IC载板（封装基板）行业市场供需态势及发展前景研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1144603.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2023-2029年中国IC载板（封装基板）行业市场供需态势及发展前景研判报告》共十一章。首先介绍了IC载板行业市场发展环境、IC载板整体运行态势等，接着分析了IC载板行业市场运行的现状，然后介绍了IC载板市场竞争格局。随后，报告对IC载板做了重点企业经营状况分析，最后分析了IC载板行业发展趋势与投资预测。您若想对IC载板产业有个系统的了解或者想投资IC载板行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

### 第1章 IC载板行业综述及数据来源说明

#### 1.1 IC载板行业界定

##### 1.1.1 IC载板是芯片封装的核心载体

###### 1、半导体制造工艺流程

###### 2、封装的定义

###### 3、封装的功能

###### 4、封装的范围（L0、L1、L2、L3）

###### 5、IC载板（IC封装载板/封装基板）的定义

###### 6、IC载板的作用

##### 1.1.2 IC载板的术语&概念辨析

###### 1、IC载板专业术语说明

###### 2、IC载板相关概念辨析

###### （1）IC载板与HDI板

###### （2）IC载板与PCB板

##### 1.1.3 国家标准中的IC载板（定义及行业归属）

#### 1.2 IC载板行业分类

##### 1.2.1 封装工艺不同

##### 1.2.2 绝缘材料不同

##### 1.2.3 封装方式不同

##### 1.2.4 封装材料不同

##### 1.2.5 应用领域不同

- 1.3 本报告研究范围界定说明
- 1.4 IC载板行业市场监管&标准体系
- 1.5 本报告数据来源及统计标准说明
  - 1.5.1 本报告权威数据来源
  - 1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

## 第2章 全球IC载板行业发展现状及市场趋势洞察

- 2.1 全球IC载板行业标准体系&技术进展
  - 2.1.1 全球IC载板行业标准体系
  - 2.1.2 全球IC载板行业技术进展
- 2.2 全球IC载板行业发展历程&产品演进
  - 2.2.1 全球IC载板行业发展历程
  - 2.2.2 全球IC载板产品演进示意图
- 2.3 全球IC载板行业市场发展现状及竞争
  - 2.3.1 全球IC载板行业市场供需状况
  - 2.3.2 全球IC载板行业细分市场分析
  - 2.3.3 全球IC载板企业兼并重组状况
  - 2.3.4 全球IC载板行业市场竞争格局
  - 2.3.5 全球IC载板行业区域发展格局
  - 2.3.6 重点区域：日本IC载板市场分析
- 2.4 全球IC载板行业市场规模体量及前景预判
  - 2.4.1 全球IC载板行业市场规模体量
  - 2.4.2 全球IC载板行业市场前景预测
  - 2.4.3 全球IC载板行业发展趋势洞悉
- 2.5 全球IC载板行业发展经验总结和有益借鉴

## 第3章 中国IC载板行业发展现状及市场痛点解析

- 3.1 中国IC载板行业发展历程分析
- 3.2 中国IC载板行业技术进展研究
  - 3.2.1 IC载板行业科研投入
  - 3.2.2 IC载板行业科研创新
  - 3.2.3 IC载板行业关键技术
    - 1、IC基板制作技术
    - 2、微孔技术
    - 3、图形形成和镀铜技术

- 4、阻焊工艺
  - 5、表面处理技术
  - 6、检测能力和产品可靠性测试技术
  - 3.2.4 IC载板行业技术路线
  - 1、IC载板行业工艺类型/技术路线
    - (1) 减除法
    - (2) 全加成法
    - (3) 半加成法
  - 2、IC载板行业工艺/技术流程图解
  - 3、IC载板行业工艺/技术路线对比
  - 3.3 中国IC载板行业对外贸易状况
  - 3.4 中国IC载板行业市场主体分析
    - 3.4.1 IC载板行业市场主体类型
    - 3.4.2 IC载板行业企业入场方式
    - 3.4.3 IC载板行业市场主体数量
    - 3.4.4 IC载板注册/在业/存续企业
  - 3.5 中国IC载板行业招投标市场解读
    - 3.5.1 IC载板行业招投标信息汇总
    - 3.5.2 IC载板行业招投标信息解读
  - 3.6 中国IC载板行业市场供给分析
    - 3.6.1 IC载板行业产线布局及扩产计划
    - 3.6.2 IC载板行业市场供给水平
  - 3.7 中国IC载板行业市场需求分析
    - 3.7.1 IC载板终端用户/行业概述
    - 3.7.2 IC载板市场需求现状分析
    - 3.7.3 IC载板市场供需平衡状况
    - 3.7.4 IC载板市场行情走势分析
  - 3.8 中国IC载板行业市场规模体量
  - 3.9 中国IC载板行业市场发展痛点
- 
- 第4章 中国IC载板行业市场竞争及投资并购状况
    - 4.1 中国IC载板行业市场竞争布局状况
      - 4.1.1 中国IC载板行业竞争者入场进程
      - 4.1.2 中国IC载板行业竞争者省市分布热力图
      - 4.1.3 中国IC载板行业竞争者战略布局状况

- 4.2 中国IC载板行业市场竞争格局分析
  - 4.2.1 中国IC载板行业企业竞争集群分布
  - 4.2.2 中国IC载板行业企业竞争格局分析
  - 4.2.3 中国IC载板行业市场集中度分析
- 4.3 中国IC载板全球市场竞争力&国产化/国际化布局
- 4.4 中国IC载板行业波特五力模型分析
  - 4.4.1 中国IC载板行业供应商的议价能力
  - 4.4.2 中国IC载板行业消费者的议价能力
  - 4.4.3 中国IC载板行业新进入者威胁
  - 4.4.4 中国IC载板行业替代品威胁
  - 4.4.5 中国IC载板行业现有企业竞争
  - 4.4.6 中国IC载板行业竞争状态总结
- 4.5 中国IC载板行业投融资&并购重组&上市情况

## 第5章 中国IC载板产业链全景及配套产业发展

- 5.1 中国IC载板产业链图谱分析
- 5.2 中国IC载板价值链——产业价值属性分析
  - 5.2.1 IC载板行业成本投入结构
  - 5.2.2 IC载板行业价格传导机制
  - 5.2.3 IC载板行业价值链分析图
- 5.3 中国IC载板基板材料（基材）市场分析
  - 5.3.1 IC载板基板材料（基材）类型
    - 1、硬质基板材料：BT树脂、ABF材料、MIS
    - 2、柔性基板材料：聚酰亚胺（PI）、PE
    - 3、陶瓷基板材料：氧化铝、氮化铝、碳化硅等陶瓷材料
  - 5.3.2 中国IC载板基板材料（基材）市场现状
  - 5.3.3 中国IC载板基板材料（基材）发展趋势
- 5.4 中国IC载板用电解铜箔市场分析
  - 5.4.1 IC载板用电解铜箔概述
  - 5.4.2 中国IC载板用电解铜箔市场现状
  - 5.4.3 中国IC载板用电解铜箔发展趋势
- 5.5 中国IC载板化学品/耗材市场分析
  - 5.5.1 IC载板化学品/耗材类型
  - 5.5.2 中国IC载板化学品/耗材市场现状
  - 5.5.3 中国IC载板化学品/耗材需求趋势

## 5.6 中国IC载板生产加工设备市场分析

### 5.6.1 中国IC载板生产加工设备类型

### 5.6.2 中国IC载板生产加工设备市场现状

### 5.6.3 中国IC载板生产加工设备需求趋势

## 5.7 配套产业布局对IC载板行业的影响总结

## 第6章 中国IC载板行业细分产品市场分析

### 6.1 中国IC载板行业细分市场概况

#### 6.1.1 中国IC载板行业细分市场对比

#### 6.1.2 中国IC载板行业细分市场结构

### 6.2 IC载板细分市场：ABF载板（硬质基板）

#### 6.2.1 ABF载板概述

#### 6.2.2 ABF载板市场简析

#### 6.2.3 ABF载板发展趋势

### 6.3 IC载板细分市场：BT载板（硬质基板）

#### 6.3.1 BT载板概述

#### 6.3.2 BT载板市场简析

#### 6.3.3 BT载板发展趋势

### 6.4 IC载板细分市场：柔性基板

#### 6.4.1 柔性基板概述

#### 6.4.2 柔性基板市场简析

#### 6.4.3 柔性基板发展趋势

### 6.5 IC载板细分市场：陶瓷基板

#### 6.5.1 陶瓷基板概述

#### 6.5.2 陶瓷基板市场简析

#### 6.5.3 陶瓷基板发展趋势

### 6.6 中国IC载板行业细分产品市场战略地位分析

## 第7章 中国IC载板行业细分市场需求分析

### 7.1 IC载板应用场景扩展&市场领域分布

#### 7.1.1 IC载板应用场景扩展

##### 1、IC载板市场定位

##### 2、IC载板应用场景

##### 2、IC载板场景扩展

#### 7.1.2 IC载板市场领域分布

## 1、IC载板市场领域分布

## 2、IC载板市场渗透概况

### 7.2 中国IC载板细分应用市场分析：存储芯片封装基板（eMMC）

#### 7.2.1 中国存储芯片发展现状

#### 7.2.2 中国存储芯片趋势前景

#### 7.2.3 存储芯片封装基板（eMMC）概述

#### 7.2.4 中国存储芯片封装基板（eMMC）需求现状分析

#### 7.2.5 中国存储芯片封装基板（eMMC）市场潜力分析

### 7.3 中国IC载板细分应用市场分析：微机电系统封装基板（MEMS）

#### 7.3.1 中国MEMS发展现状

#### 7.3.2 中国MEMS趋势前景

#### 7.3.3 微机电系统封装基板（MEMS）概述

#### 7.3.4 中国微机电系统封装基板（MEMS）需求现状分析

#### 7.3.5 中国微机电系统封装基板（MEMS）市场潜力分析

### 7.4 中国IC载板细分应用市场分析：射频模块封装基板（RF）

#### 7.4.1 中国射频模块发展现状

#### 7.4.2 中国射频模块趋势前景

#### 7.4.3 射频模块封装基板（RF）概述

#### 7.4.4 中国射频模块封装基板（RF）需求现状分析

#### 7.4.5 中国射频模块封装基板（RF）市场潜力分析

### 7.5 中国IC载板细分应用市场分析：处理器芯片封装基板

#### 7.5.1 中国处理器芯片发展现状

#### 7.5.2 中国存处理器芯片趋势前景

#### 7.5.3 处理器芯片封装基板概述

#### 7.5.4 中国处理器芯片封装基板需求现状分析

#### 7.5.5 中国处理器芯片封装基板市场潜力分析

### 7.6 中国IC载板细分应用市场分析：高速通信封装基板

#### 7.6.1 中国高速通信封装基板发展现状

#### 7.6.2 中国高速通信封装基板趋势前景

#### 7.6.3 高速通信封装基板概述

#### 7.6.4 中国高速通信封装基板需求现状分析

#### 7.6.5 中国高速通信封装基板市场潜力分析

## 第8章 全球及中国IC载板企业布局案例解析

### 8.1 全球及中国IC载板主要企业布局梳理



## 8.2 全球IC载板主要企业布局案例分析

### 8.2.1 日本揖斐电株式会社（IBIDEN）

- 1、企业概况
- 2、企业经营状况
- 3、企业盈利能力
- 4、企业市场战略

### 8.2.2 韩国三星电机（SAMSUNG）

- 1、企业概况
- 2、企业经营状况
- 3、企业盈利能力
- 4、企业市场战略

## 8.3 中国IC载板主要企业布局案例分析

### 8.3.1 欣兴电子股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业经营状况
- 3、企业盈利能力
- 4、企业市场战略

### 8.3.2 景硕科技股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业经营状况
- 3、企业盈利能力
- 4、企业市场战略

### 8.3.3 南亚电路板股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业经营状况
- 3、企业盈利能力
- 4、企业市场战略

### 8.3.4 日月光半导体制造股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业经营状况
- 3、企业盈利能力
- 4、企业市场战略

### 8.3.5 深南电路股份有限公司

- 1、企业概况
- 2、企业经营状况

3、企业盈利能力

4、企业市场战略

8.3.6 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

1、企业概况

2、企业经营状况

3、企业盈利能力

4、企业市场战略

8.3.7 珠海越亚半导体股份有限公司

1、企业概况

2、企业经营状况

3、企业盈利能力

4、企业市场战略

8.3.8 深圳丹邦科技股份有限公司

1、企业概况

2、企业经营状况

3、企业盈利能力

4、企业市场战略

8.3.9 崇达技术股份有限公司

1、企业概况

2、企业经营状况

3、企业盈利能力

4、企业市场战略

8.3.10 惠州中京电子科技股份有限公司

1、企业概况

2、企业经营状况

3、企业盈利能力

4、企业市场战略

第9章 中国IC载板行业发展环境洞察&SWOT分析

9.1 中国IC载板行业经济（Economy）环境分析

9.1.1 中国宏观经济发展现状

9.1.2 中国宏观经济发展展望

9.1.3 中国IC载板行业发展与宏观经济相关性分析

9.2 中国IC载板行业社会（Society）环境分析

9.2.1 中国IC载板行业社会环境分析

## 9.2.2 社会环境对IC载板行业发展的影响总结

## 9.3 中国IC载板行业政策（Policy）环境分析

### 9.3.1 国家层面IC载板行业政策规划汇总及解读

#### 1、国家层面IC载板行业政策汇总及解读

#### 2、国家层面IC载板行业规划汇总及解读

### 9.3.2 31省市IC载板行业政策规划汇总及解读

#### 1、31省市IC载板行业政策规划汇总

#### 2、31省市IC载板行业发展目标解读

### 9.3.3 国家重点规划/政策对IC载板行业发展的影响

#### 1、国家“十四五”规划对IC载板行业发展的影响

#### 2、《重点新材料首批次应用示范指导目录》对IC载板行业发展的影响

### 9.3.4 政策环境对IC载板行业发展的影响总结

## 9.4 中国IC载板行业SWOT分析

## 第10章 中国IC载板行业市场前景及发展趋势分析

### 10.1 中国IC载板行业发展潜力评估

### 10.2 中国IC载板行业未来关键增长点分析

### 10.3 中国IC载板行业发展前景预测

### 10.4 中国IC载板行业发展趋势预判

## 第11章 中国IC载板行业投资战略规划策略及建议

### 11.1 中国IC载板行业进入与退出壁垒

#### 11.1.1 IC载板行业进入壁垒分析

#### 11.1.2 IC载板行业退出壁垒分析

### 11.2 中国IC载板行业投资风险预警

### 11.3 中国IC载板行业投资机会分析

#### 11.3.1 IC载板产业链薄弱环节投资机会

#### 11.3.2 IC载板行业细分领域投资机会

#### 11.3.3 IC载板行业区域市场投资机会

#### 11.3.4 IC载板产业空白点投资机会

### 11.4 中国IC载板行业投资价值评估

### 11.5 中国IC载板行业投资策略与建议

## 图表目录

### 图表1：IC载板专业术语说明

图表2：IC载板相关概念辨析

图表3：《国民经济行业分类与代码》中本报告研究行业归属

图表4：IC载板的分类

图表5：本报告研究范围界定

图表6：中国IC载板行业监管体系结构图

图表7：中国IC载板行业主管部门&行业协会&自律组织机构职能

图表8：IC载板行业标准体系框架&建设进程

图表9：中国IC载板行业现行&即将实施标准汇总

图表10：中国IC载板行业重点标准及其影响解读

图表11：本报告权威数据资料来源汇总

图表12：本报告的主要研究方法及统计标准说明

图表13：全球IC载板行业标准体系&技术进展

图表14：全球IC载板行业发展历程&产品演进

图表15：全球IC载板行业兼并重组状况

图表16：全球IC载板行业市场竞争格局

图表17：全球IC载板行业市场发展现状

图表18：全球IC载板行业供需状况

图表19：全球IC载板行业细分市场分析

图表20：全球IC载板企业兼并重组状况

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1144603.html>